

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2021-021

杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配比例及转增比例：

每 10 股派发 1.10 元现金红利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实

现营业收入 1,502,017,793.75 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 201,957,668.83 元，母公司实现净利润 66,754,068.43 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以母公司 2020 年度净利润为基数提取 10%的盈余公积 6,675,406.84 元，连同上年末的未分配利润 143,881,478.24 元、扣除 2020 年已实施的 2019 年度利润分配 18,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配的未分配利润为 185,960,139.83 元。

经公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 400,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.10 元现金红利（含税），共计派发现金红利 44,063,800.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.82%，剩余未分配利润 141,896,339.83 元结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 201,957,668.83 元，母公司实现净利润 66,754,068.43 元。公司拟分配的现金红

利总额预计为 44,063,800.00 元,占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务主要分三大板块,分别是半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片。主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6 英寸肖特基芯片和 MOSFET 芯片、6 英寸砷化镓微波射频芯片等三大类。产品的应用广泛,主要的应用领域包括通信、计算机、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及 5G、物联网、工业控制、航空航天等产业。

公司主营的三大业务板块具有技术复杂、生产流程长和制造工序多的特点,制造工艺复杂、技术壁垒高,需要投入大量资金购置先进研发、生产和检测设备。为保持产品的持续竞争力,企业必须不断对生产设备和工艺进行升级改造,并保持较高的研发投入,以紧跟行业更迭步伐。因此,公司主营的三大业务板块是技术和资本密集型行业,需要大量资金进行设备等资本投入以实现生产规模的扩大、同时需要充足的现金流以满足日常经营和技术研发的需求。

（二）上市公司发展阶段

公司目前正处于快速扩张的阶段。为抓住 5G 移动通信、汽车电子等产业的发展机遇,增强公司资本实力,补充公司业务发展所需资金,丰富公司产品类型,提高生产能力,增强公司营运能力、提升盈利水平,进一步夯实公司在行业中的市场地位,公司于 2021 年 3 月

12 日公告了再融资项目的预案，拟发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 520,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”、“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”、“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”三个生产项目及补充流动资金，详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告（编号 2021-008）。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

依托公司衢州硅片生产基地上马，以及宁波硅片生产基地、杭州功率器件生产基地的技改升级、技术研发等持续投入，公司近几年实现了稳定、健康的发展，生产规模得到较为快速的扩张。

项目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入（元）	1,502,017,793.75	1,191,685,953.89	1,222,666,990.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,957,668.83	128,187,904.69	180,759,755.45

公司决定及正在实施中的“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”、“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”、“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”三个项目预算需要投入资金 492,365 万元，资金需求量大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》关于现金分红比例的要求进行。

由于公司决定及正在实施中的“年产180万片集成电路用12英寸硅片”、“年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目”、“年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目”三个项目预算需要投入资金492,365万元，2021年有重大资金支出安排。

按照《公司章程》第一百五十三条的规定“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”，公司目前正处于快速扩张的阶段，且2021年有重大资金支出安排，因此2020年的现金分红比例为21.82%，以确保公司的短期稳健和长远发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润，主要用于新项目固定资产投资、产线升级改造、新产品和新技术的研发等。公司决定及正在实施中的“年产180万片集成电路用12英寸硅片”、“年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目”、“年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目”三个项目建成达产后，预计每年可实现不含税销售收入247,710万元，每年新增税后利润43,123万元。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

1、公司 2020 年度利润分配预案的议案综合考虑了公司的经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，公司 2021 年将面临项目建设等重大资本支出、以及快速发展阶段对大额流动资金需求的压力，同时兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。

2、本议案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司于 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于杭州立昂微电子股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》中关于现金分红比例的要求，审批程序符合法律、法规的要求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

同意本次利润分配预案的议案并将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司于 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于杭州立昂微电子股份有限公司股东未来分红回报规划的议

案》中关于现金分红比例的要求。议案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序审议本次利润分配预案的议案，议案获得董事会三分之二以上出席董事的同意，独立董事发表了同意的独立意见。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案的议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日